



(0.80 mm) .0315"

HSEC8-120-01-L-RA

HSEC8-160-01-L-RA-BL

HSEC8-RA SERIES

RIGHT-ANGLE EDGE RATE® CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?HSEC8-RA

Insulator Material:

Black Liquid Crystal Polymer

Contact:

BeCu

Plating:

Au or Sn over

50 μ" (1.27 μm) Ni

Current Rating:

2.6 A per pin

(2 adjacent pins powered)

Operating Temp:

-55 °C to +125 °C

RoHS Compliant:

Yes

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (10-60)

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

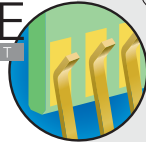
ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Other platings

Card Mates:
(1.60 mm) .062" thick card,
HSC8

Cable Mates:
ECDP

EDGE
RATE
CONTACT



Rugged
Edge Rate®
contacts
designed for
Signal Integrity

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

HSEC8-RA

Rating based on Samtec reference channel.
For full SI performance data visit Samtec.com
or contact SIG@samtec.com

28
Gbps

Accepts (1.60 mm) .062"
PCB thicknesses

Optional
Board
Locks

RUGGEDIZED
BY SAMTEC

- Board lock option

HSEC8

1

POSITIONS
PER ROW

CARD
THICKNESS

PLATING
OPTION

RA

OTHER
OPTION

09, 10, 13, 20, 25,
30, 40, 49, 50, 60

-01
= (1.60 mm) .062"
thick card

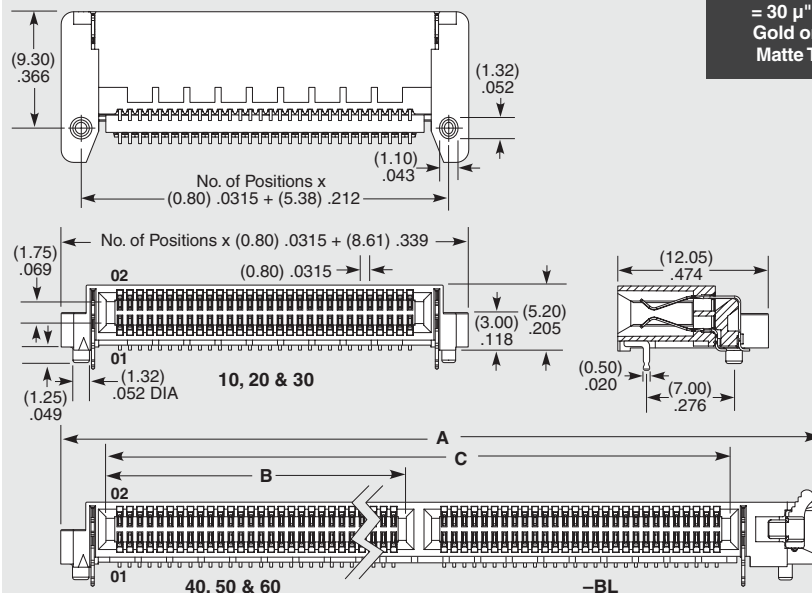
-L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on contact,
Matte Tin on tail

-S
= 30 μ" (0.76 μm)
Gold on contact,
Matte Tin on tail

-BL
= Board Locks
(09, 13, 25, 40,
49, 50, 60 only)

-L2
= ECDP Latching
(09, 13, 25,
49 only)
(For use with
ECDP)

-TR
= Tape & Reel
Packaging
(10 thru 60
positions only)



POSITIONS PER ROW	A	B	C
40	(43.80) 1.724	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50	(51.80) 2.039	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60	(59.80) 2.354	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071
40-BL	(51.30) 2.020	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50-BL	(59.30) 2.335	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60-BL	(67.30) 2.650	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071

Notes:
While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9